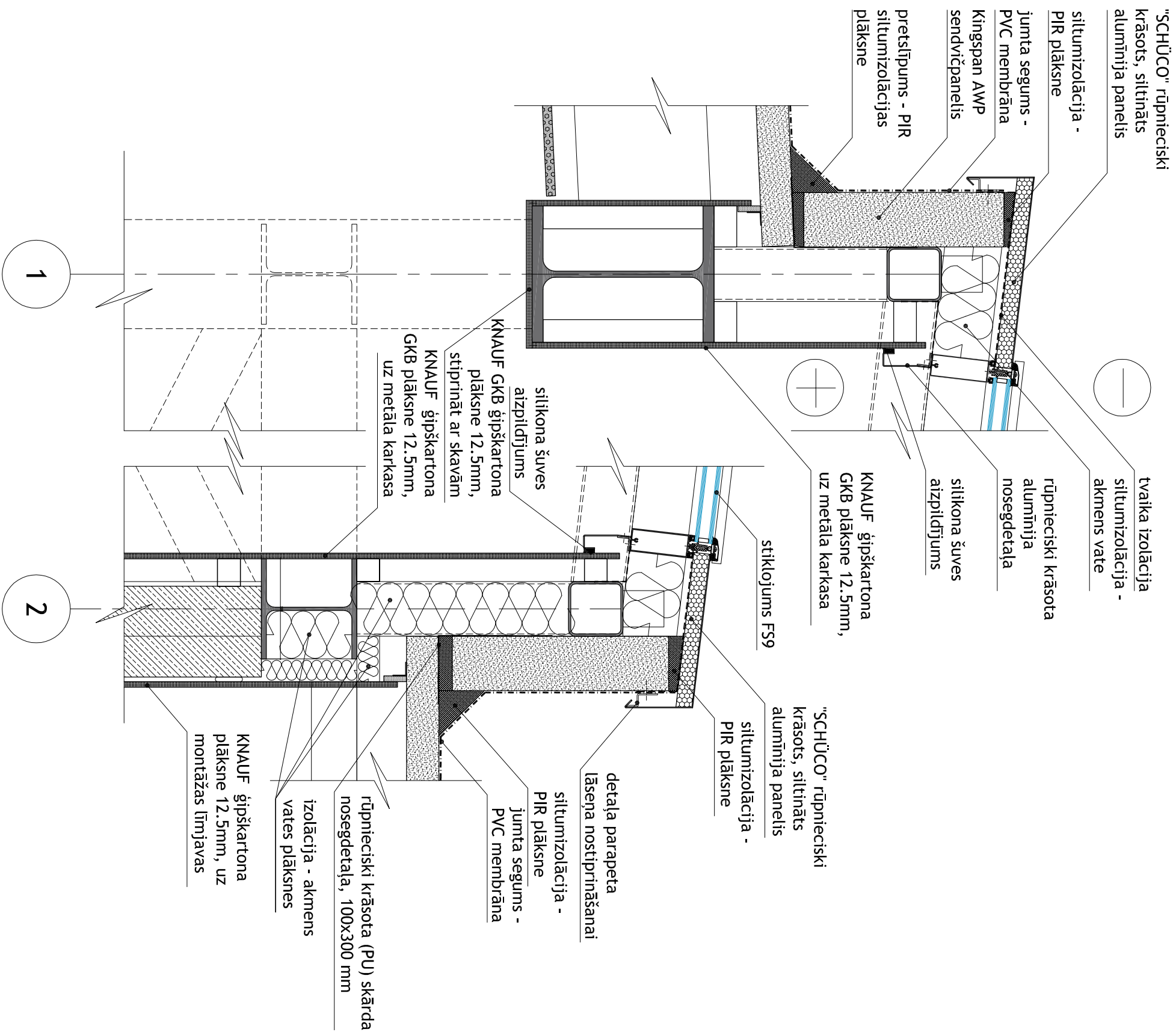



mezgls g

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atz. metros.
2. Parapeta apdare - horizontāli montāts sendvičpanelis KINGSPAN KS 1000 AWP ar slēptu horizontālo šuvi, paneļa b=120mm. Ārējās virsmas tips - Micro, panelu saslēguma vertikālā šuve nosepta ar detaļu K175a (KINGSPAN sortiments).
3. Jumta nesošo konstrukciju ugunsizturību, saskaņā ar UPF, paredzēts nodrošināt ar atbilstošu krāsojumu, ģipškartona plākšņu apdarei dekoratīva funkcija.
4. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē ar 10cm pārklaidumu un jāizolē ar Tescon Invis lentu.
5. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē pamata virspusē.
6. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē parapeta virspusē.
7. Rasējumā dotos izmērus lasīt, ja nepieciešama papildus informācija, bet rasējumā tā nav uzrādīta, vērsties pie arhitekta, mērīt rasējumu aizliegts.

Atbildīgais projektētājs				ARHITEKTU BIROJS SIA "ER" RĪGA, VIDRIČU 4-136, LV-1000	
BPV	RALFS ROZENVALDS				
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS				
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA				
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE				
Pasūtītājs	Ventspils Brīvostas pārvalde	Pasūt. Nr.	VP-EC-11		
Objekts	Elektronikas centra ēka Kaiju ielā 9, Ventspilī	Stādīja	TF		
		Lapa	ARD-30		
		Mērogs	1:1		
Faiss	Mezglis_īestrades-2014_01_23.dwg	Arh.reg. Nr.			
Rasējums	Virsgaismas stiklojuma FS09 iebūve, mezgls 9	Datums	27.01.2014		